

2024年3月期 第1四半期 決算説明会 Q&A

●第1回：2023年7月28日（Q1～Q16）

●第2回：2023年8月31日（Q17～Q19）

第1回 2023年7月28日（Q1～Q16）		
Q1	HD/ SPE	前受金の増加は、2Qから増えてくるSPE・中国向け売上案件の分か？また2Qから営業利益率（OPM）が改善する予想だが、これも中国案件の増加が寄与するのか？
A1		<ul style="list-style-type: none"> ・前受金の増加についてはその理解のとおり。 ・OPM改善には中国案件が増えることだけではなく、新工場S³-4の稼働が本格化することも寄与。
Q2	SPE	来期の中国需要の継続性、また先端デバイスの投資の動きはどう見るか？
A2		<ul style="list-style-type: none"> ・今期ほどの高い（売上）比率にはならないとしても、投資は継続されると見ている。 ・先端ファウンドリー・ロジックについては、今期の終わりぐらいから受注が増える予想であり、来期業績のメインとなる見込み。
Q3	SPE	プレゼン資料 17ページ、アプリケーション別売上構成比の上期ファウンドリー比率は、納入時期のずれで期初想定（5月決算）から少し減ったと考える。その他アプリケーションの動向はどうか？また通期で（アプリケーションとして）何か特徴はあるか？
A3		ご指摘の通り、上期のファウンドリー比率減少は下期への期ずれが要因。通期でDRAMが強く見えるが、中国での新規DRAM投資案件が背景にある。
Q4	SPE	先期から持ち越しの中国商談は、来期にもまだ残るのか？また（中国からの）新規案件は、来期も増えていくのか？
A4		持ち越し案件については今期中に全て届けたいと思っている。新規案件については、想定以上にさまざまなお客さまが投資を検討されている状況。全てが今期の生産枠に入るかどうかのコメントは時期尚早と考える。
Q5	SPE	上期売上の期ずれについて、もう少し背景を説明して欲しい。
A5		既に報道されているお客さまの工場建設の遅れが原因。需要減速が要因ではない。
Q6	HD/SPE	通期の業績予想を据え置かれたが、為替レートの見直しなどを考えると実際の物量面では見通しを下げているのでは？
A6		30億円程度の為替差益が見込めるが、まだ1Qという事もあり、通期予想は据え置いた。物量については、受注残を着実にこなしていく事で下期に向けて上げていけるだろう。
Q7	SPE	CY2024のWFEの見通しは？
A7		<ul style="list-style-type: none"> ・メモリー市況の回復がどうなるかが最大のポイント。メモリー投資の再開は来期下期を期待している。 ・ロジック、ファウンドリーは今期弱含みだが、来期は先端投資を含めて上がってくるだろう。

Q8	SPE	来期売上計画の目線は？
A8		<ul style="list-style-type: none"> ・WFE の影響も当然受けるが、足元の市場環境やお客さまの計画を見ていると、来期も増収増益を望めるであろう。 ・CY2024 の WFE 自体は若干プラスではないかと考えている。SEAJ によれば、来年度日本製半導体製造装置の市場は上がるとの見立てであり、暦年と会計年度の違いはあるが、当社の事業年度に寄与すると考える。
Q9	SPE	生成 AI での事業機会はどうか？
A9		まだ具体的な引き合いは見えていないものの、当社もアドバンスドパッケージ分野での投資について働きかけをしており、今後成果が出てくることを期待している。
Q10	SPE	上期のアプリケーション別売上予想で、5 月決算時の予想より、DRAM が増えて「その他」が減った理由は？
A10		DRAM については中国新興企業の売上が 2Q で増加する見込み。「その他」の減少については特に特徴があるわけではなく、さまざまなお客さまの投資動向が反映された結果。
Q11	SPE	売上が上期から下期へ 150 億円スライドして営業利益（OP）が 35 億円しか変動しない背景は？
A11		通期予想を据え置いたため。上期は予想通りの着地となるう。
Q12	SPE	今期から来期に売上がずれ込む案件はあるのか？
A12		受注済みの案件は今期で納入していけるが、2Q 以降の受注案件が今期納入出来るかは今後の検討となる。
Q13	SPE	期初計画（5 月予想）より上期の中国向け売上比率が相当増えている。北米顧客売上の下期へのシフトが、中国比率を増やしているのか？
A13		ご理解のとおり。期初計画よりも中国向け比率が増えた分、他の案件は来期以降にずれているとお考えいただきたい。
Q14	SPE	今期の中国売上比率が市場平均よりも高い要因は？
A14		前期納入出来なかったお客さま向け案件を今期納入しているのが当社の状況。前期と今期の比率を均してみれば、市場とさほど違いは無かるう。
Q15	SPE	生成 AI の影響で HBM（High Bandwidth Memory）のキャパシティー増など好影響が出ているが、HBM への投資で何か SCREEN への恩恵はあるか？
A15		当社はメモリーのお客さまへの売上比率が相対的に低いため、恩恵という点では他社比アンダーパフォームするかもしれない。他方、生成 AI 使用の拡大でメモリー使用が増えるということは、市場全般へ波及することであるので、少なからず恩恵を享受できる。
Q16	SPE	中国売上比率の高まりは、今後ポストセールス（PS）の売上増に貢献するか？
A16		中国においても PS 比率は徐々に上がっていくだろう。他の市場同様 20%程度の比率になると思っている（但し米国の規制により米国製のパーツは販売できない）。
第2回 2023年8月31日（Q17～Q19）		
Q17	GA	1Q は好調に見えるが、足元の状況と今後の見通しは？
A17		1Q は為替の影響もあり好調だった。これまで好調だった北米はインフレ影響により POD 需要は弱含んでいるが、欧州が回復してきた。上期は予想どおりの着地を想定している。
Q18	FT	足元の状況と今後の見通しは？

A18		業績としては今期がボトムと考えている。受注動向は改善しつつあり、来期は黒字化を目指したい。
Q19	PE	足元の状況と今後の見通しは？
A19		プリント基板業界は半導体投資と連動するため、商談は2023年後半から徐々に改善すると見ている。来期の市場成長に向け、新製品投入・開発投資をしっかりと行っていく。

HD: ホールディングス、SPE: 半導体製造装置事業、GA: グラフィックアーツ機器事業、
FT: ディスプレー製造装置および成膜装置事業、PE: プリント基板関連機器事業